

2026年度 (2027年3月期) 第1四半期 決算説明会

2026/08/04

株式会社東京精密

代表取締役社長CEO	木村 龍一
執行役員常務 CFO	小泉 公人
経営支援室 IRチームリーダー	高嶋 直樹

- ・ **将来の事象に係る記述に関する注意：** 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界、ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。
- ・ **用語について：** 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」、中期経営計画を「中計」と記載します。
- ・ **記入データについて：** 記載されている金額や比率の情報は「億円」、またはパーセント(%)による要約表示を行っております。その為、内訳の計が合計と一致しない場合があります。
- ・ **監査について：** 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

エグゼクティブサマリー

2026年度 第1四半期 業績	・ 全社受注高は658億円(前年同期比83%増)と四半期ピークを更新、特に半導体製造装置部門で増進(同102%増) ・ 前年同期増収(同19%)、営業増益(同29%)
足許の 事業環境	・ 半導体製造装置の強い引合いは続いている ・ 計測機器も、緩やかな成長基調を維持 ・ 生産部門は繁忙な状況が続き、キャパシティ増に向けた追加投資を検討
2026年度 業績予想	・ 受注残高ならびに事業環境を踏まえ、通期業績予想を修正(全社売上高 1,815億円→1,890億円、営業利益400億円→440億円) ・ 業績予想修正を受けて 配当予想を更新(1株276円→304円)

- 代表取締役社長CEOの木村です。
本日はご多忙のところ、ご参加いただきまして 厚く御礼申し上げます。
- まず私から、2ページ目、本日の説明のサマリーを説明いたします。
- 2026年度第1四半期の業績のポイントは、やはり受注高です。前年同期比で、全社で83%、半導体製造装置部門で倍増となりました。売上高や利益も前年同期比で増加しております。
- 足許の事業環境ですが、この半導体での強い引合いは続いているほか、計測事業でも緩やかな成長が続いています。
- 生産部門は繁忙な状況が続いており、このほど、キャパシティ増加に向けて、追加投資の検討を開始しました。このため通期の設備投資額の計画を修正しました。
- 2026年度の業績予想ですが、受注残高や足許の状況を勘案し、売上高で75億円、営業利益で40億円 上方修正しました。この修正を踏まえて、年間配当予想も更新しております。
- サマリーは以上となります。では小泉より第1四半期の実績を説明します。

2026年度 第1四半期 連結業績

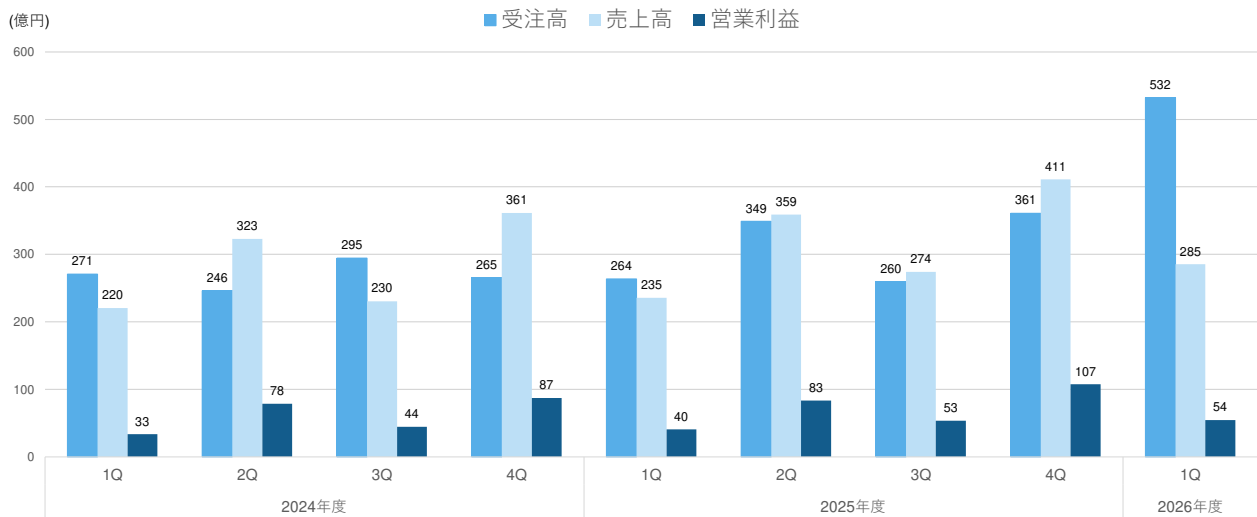
全社売上高・利益は前年を上回る実績、受注高は既往ピーク更新 (2Qの売上高・利益は1Q比増加計画)

全社業績(億円)		2025年度				2026年度		
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前四半期比	前年同期比
受注高		359	447	366	458	658	+44%	+83%
売上高		309	462	359	539	367	-32%	+19%
営業利益		46	101	62	128	59	-54%	+29%
(利益率)		(15%)	(22%)	(17%)	(24%)	(16%)	-8pt	+1pt
経常利益		45	105	67	131	64	-51%	+44%
当期純利益		32	64	45	106	47	-56%	+45%
研究開発費		25	30	29	36	33	-6%	+34%
設備投資		25	44	15	27	19	-28%	-23%
減価償却費		12	14	14	16	14	-5%	+17%
セグメント別業績		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前四半期比	前年同期比
半導体 製造装置	受注高	264	349	260	361	532	+47%	+102%
	売上高	235	359	274	411	285	-31%	+21%
	営業利益	40	83	53	107	54	-50%	+34%
	(利益率)	(17%)	(23%)	(20%)	(26%)	(19%)	-7pt	+2pt
計測機器	受注高	95	98	107	97	126	+29%	+32%
	売上高	73	103	85	128	82	-36%	+12%
	営業利益	5	18	9	21	5	-75%	-7%
	(利益率)	(7%)	(18%)	(10%)	(16%)	(6%)	-10pt	-1pt

- 執行役員常務CFOの小泉です。よろしくお願い致します。私からは2026年度第1四半期、1Qの業績を説明させていただきます。
- 3ページは1Q業績の総括です。
- 上段の1列目、全社受注高は658億円となり、高水準だった前年4Qを上回り、既往ピークを更新しました。中段にある通り、半導体の受注高が500億円を超える高水準でした。
- 2列目、売上高は、全社で367億円、これは高水準だった前年4Qから減少しているものの、前年1Q比増の数字です。同様に営業利益も、前年1Q比で29%増加しました。この1Qの実績は、期初の見込みをやや下回る水準ですが、要因は出荷タイミングの月ズレなどによるものです。5月の説明会でもお示した通り、2Qは1Q比で、大幅な増収を見込む形となります。

半導体製造装置セグメント 業績推移

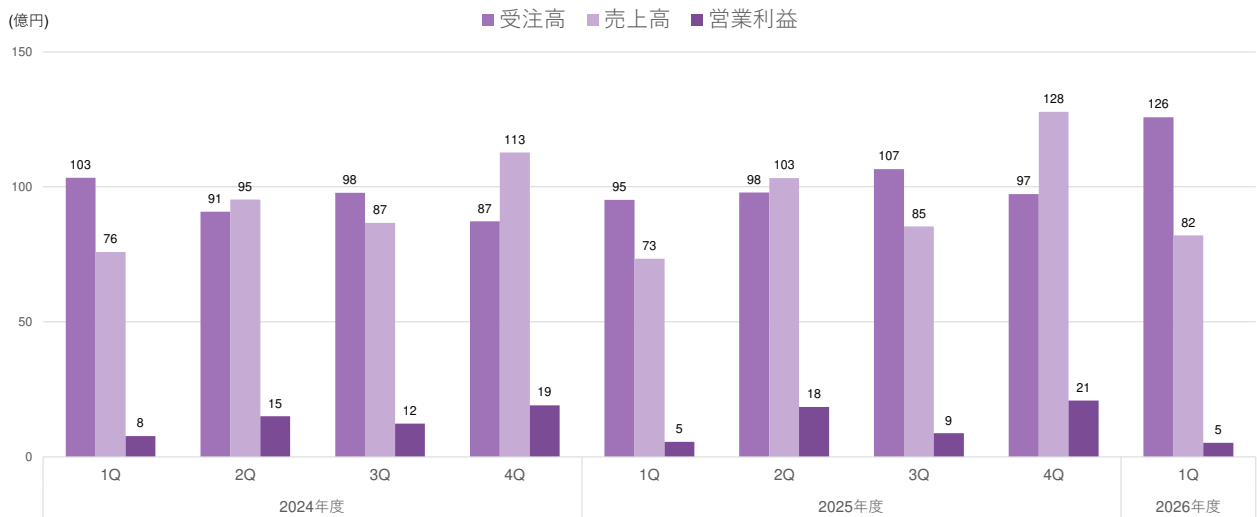
第1四半期の受注高は、生成AIを含むHPC案件に加え、中国案件や他の引合いも強く、想定を大幅に上回る水準で着地



- 4ページは、半導体の受注高・売上高・営業利益の四半期推移をグラフで示したものです。受注高について説明いたします。
- 1Qの受注高は532億円で、これは会社想定を100億円以上 上回る水準でした。以前から続いているHPC向けの受注が続いたほか、中国案件が堅調で、受注高の半分弱が中国からの受注となりました。さらに、その他のデバイス関連の需要も強かったことで、計画を大きく上振れました。なお、業績予想の部分でも触れますが、2Q案件の前倒し分も含まれていると分析しています。
- なお、当社は、毎四半期、売上の実現性が低いと判断した受注残高の整理を行っておりますが、この1Qも10億円弱発生しております。
- 詳細な定量情報は、開示資料の後半、補足資料に入れておりますので、併せてご覧ください。

計測機器セグメント 業績推移

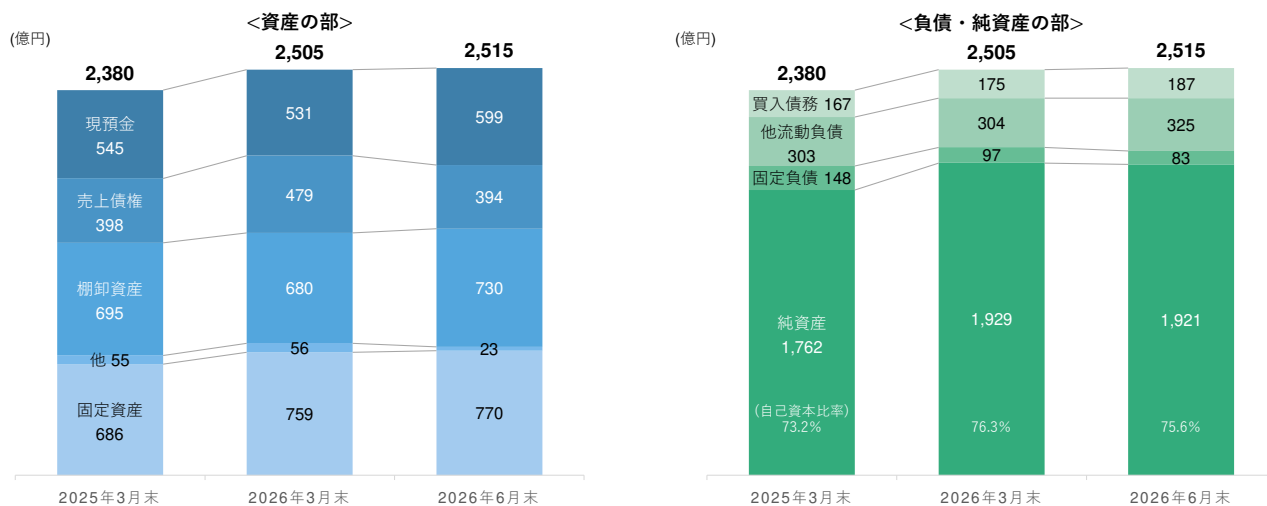
第1四半期の受注高は、HV車生産に関連した追加投資、AIデータセンタ・ロボット等の恩恵を受け高水準



- 5ページは、計測の受注高・売上高・営業利益の四半期推移です。
- 第1四半期の受注高は126億円で、こちらも会社想定の中から10億円強の上振れとなりました。
- これは、ハイブリッド車生産に関連する追加投資に加え、AI向けデータセンタ関連(インフラ含む)、省人化にむけたロボット関連、さらに外需を中心としたものづくり市場の回復により計測機器の引合いが全体的に強まったためと理解しています。

貸借対照表

3月末比で現預金および棚卸資産が増加

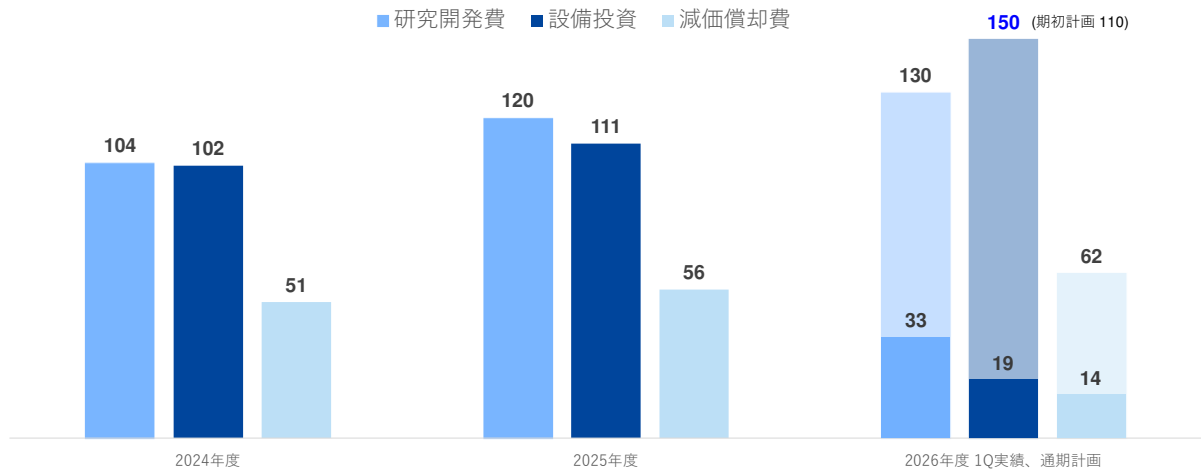


- 6ページは貸借対照表の説明です。
- 2026年6月末の総資産は、2,515億円で、3月末から軽微な増加でした
- 左側、資産の部ですが、売上債権の回収により現預金が増加したほか、今後の出荷増加を想定した棚卸資産の増加がありました。
- 右側、負債・純資産の部では、買入債務が増加しました。
- 6月末の自己資本比率は 75.6%となりました。

研究開発費・設備投資・減価償却費

第1四半期実績は概ね計画通り。生産増強の投資を行うため 設備投資計画を+40億円修正

(億円)



- 7ページは研究開発費・設備投資・減価償却費の実績と計画です。
- 右側、2026年度ですが、1Qの実績は、概ね計画線でした。
- なお、設備投資計画ですが、足許の強い引合いに応えるべく、プローバを中心に生産能力の増強、キャパシティの拡大を行うことを検討しております。そのため、通期の計画を修正いたしました。
- 以上が、第1四半期の実績説明となります。次に、木村から、2026年度の見通しについて説明いたします。

2026年度通期業績予想の前提 (青字：8月変更)

売上・営業利益

半導体： **足許の需要を反映し、下期中心に計画を見直し(上方修正)**

- 生成AIを含むHPC：引き続き売上高・利益に大きく貢献(4割半ば程度)
- グローバルOSAT：HPC向けに加え他ロジック向けの増加を想定
- 中国需要：ハイエンド需要を中心に高水準
- 汎用メモリ：DRAM/NAND向けの出荷増加

計測：市場全般で成長基調、下期中心に売上計画を見直し(上方修正)

利益：各種コスト・生産強化に伴う費用増はあるが、高付加価値製品比率の増加・原価改善+αを通じ中期経営計画目標に近づける

受注動向

半導体： **上期は非常に堅調な受注環境。下期計画は未策定だが、上期と同等水準が想定される**

- 生成AIを含むHPC：上期はロジック向けの増加を主因に2025年度下期比で増加
- グローバルOSAT：全般に引き合いが強まる。
- 中国需要：ハイエンド需要が継続すると想定
- 汎用メモリ：DRAM/NAND向けの引き合いが加速

計測：航空・宇宙・防衛分野、AIインフラ・半導体関連需要の増加、及び補助金の活用による引合増加を想定

- 木村です。私から2026年度の通期見通しについて説明します。
- 8ページは、5月に示した 2026年度通期業績予想の前提に、青字でアップデートを入れたものです。
- 上段、売上・利益面の考え方ですが、先ほど小泉が説明した通り、強い受注環境が続いています。このうち一部で、下期の売上が見込めることを主因に、下期の予想を上方修正しました。
- これに伴い、利益も上乘せが可能となる一方で、生産増加に伴うコスト増加もあります。引き続き、付加価値の高い製品を通じた利益増加を狙っています。
- 下段、受注動向です。半導体を中心に、強い受注環境が続くとみています。現時点で下期の業務計画は確定しておりませんが、上期と同水準の受注計画が作れるのではないかとみています。

2026年度通期業績予想

2026年5月13日に開示した業績予想を、下期を中心に修正(半導体・計測とも上方修正)

前提為替レートは150円/ドル(為替変動影響は軽微:円建て比率高)で変更なし

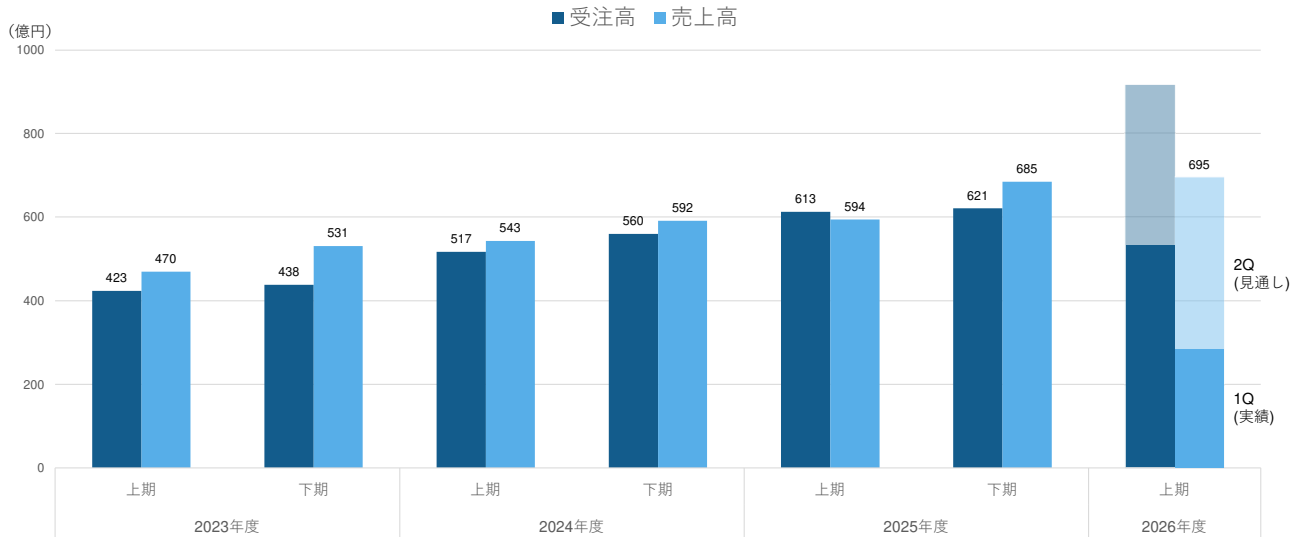
業績予想変更に伴い、1株配当予想も変更

全社業績(億円)	2025年度 上期	下期	通期	2026年度 上期予	下期予	通期予	前回予想増減	前期比
受注高	806	825	1,631	-	-	-	-	-
売上高	771	898	1,668	885	1,005	1,890	+75	+13%
営業利益	147	190	337	191	249	440	+40	+30%
(利益率)	(19%)	(21%)	(20%)	(22%)	(25%)	(23%)	+1pt	+3pt
経常利益	150	199	348	191	249	440	+40	+26%
当期純利益	96	151	247	134	174	308	+28	+24%
研究開発費	55	65	120	-	-	130	±0	+8%
設備投資	69	42	111	-	-	150	+40	+36%
減価償却費	27	29	56	-	-	62	±0	+11%
セグメント売上高	2025年度上期	下期	通期	2026年度 上期予	下期予	通期予	前回予想増減	前期比
半導体製造装置	594	685	1,279	695	780	1,475	+60	+15%
計測機器	177	213	390	190	225	415	+15	+7%
1株配当(円)	111円	151円	262円	152円	152円	304円	+28円	+42円

- 以上を踏まえ、5月13日に開示した、2026年度の通期業績予想を9ページのよう
に修正しました。
- 具体的には、売上高で、半導体で60億円、計測で15億円、全社で75億円の上方
修正となり、中期経営計画の定量目標を超える水準の予想となりました。
- 営業利益は、40億円の上方修正で、440億円の予想となります。売上増加に
伴う利益の増加が見込める一方で、生産増に伴う販管費の増加を新たに織り
込みました。
- 経常利益、当時純利益の予想はご覧の通りとなっています。
- 前提為替レートは、1ドルが150円に変更はございません。
- また、下段にあるように、配当予想も修正しております。こちらは適時開示
も併せてご覧ください。

半導体製造装置セグメント- 売上・受注高 半期見込

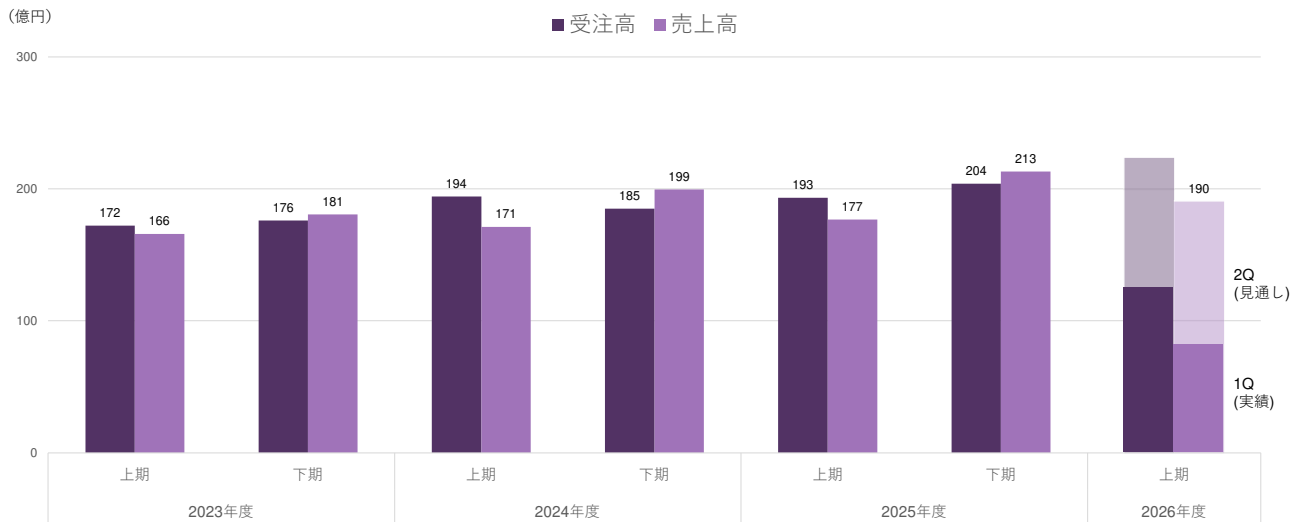
2026年度上期受注高想定を見直し。前下期比で約20%増→ 約50%増加へ変更 (2Qは前倒しもあったとみられQoQ減少想定)



- 10ページは、半導体事業の 売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- この上期の受注高の見込みを上方修正しました。期初は、前下期比で約20%程度の増加を想定していましたが、現在は約50%増加する想定です。なお、先ほど小泉が説明しましたが、1Qの受注には、前倒し分を多く含まれていたとみられ、2Qの受注高は1Q比で多少減る見通しですが、それでも高水準になるものとみています。
- なお、上期予想の製品構成比は、売上高で、プローバ 7割前半、加工装置 2割後半、受注高は、プローバは7割半ば、加工装置2割半ばを想定しています。
- 引き続きプローバの好況が見込まれています。

計測機器セグメント – 売上・受注高 半期見込

2026年度上期受注高見通しに変更なく、前年同期比で10%増を想定



- 11ページは、計測事業の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- 上期の受注高は、前回予想を据え置いており、前年度下期比で約10%の増加を想定しています。2Qの受注高は、季節性により1Q比で減少する見込みです。
- 上期予想の製品構成比は、売上高で、汎用計測が7割前半、自動計測が2割、残りが充放電試験システム、受注高で汎用計測が6割半ば、自動計測が2割半ば、残りが充放電試験システムを想定しています。
- 以上で私からの説明を終わります。ご清聴 ありがとうございました。

質疑応答 / Q&A

Supplementary Data - 生成AIを含むHPC / HPC-related business incl. Gen.AI

<売上高/Sales>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度上期 FY2026/3 1H	2025年度下期 FY2026/3 2H	2026年度上期予 FY2027/3 1H (f)
生成AIを含むHPC全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +55% HoH	前半期比 +32% HoH	前半期比 +29% HoH
うちロジック (生成AIを含む) of which Logic (incl. Gen AI)	前半期比 +81% HoH	前半期比 +11% HoH	前半期比 +78% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +28% HoH	前半期比 +64% HoH	前半期比 -15% HoH
SPE売上高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE sales	30%強 / Low 30%	30%半ば / Mid-30%	40%半ば / Mid 40%

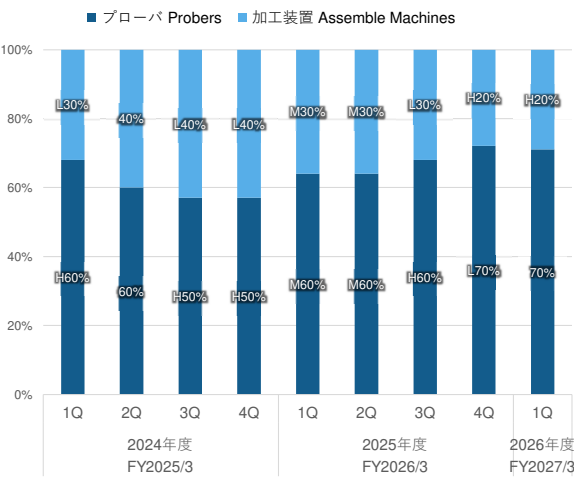
<受注高/Orders>

(前半期比増減率 / HoH Changes)	2025年度上期 FY2026/3 1H	2025年度下期 FY2026/3 2H	2026年度上期予 FY2027/3 1H (f)
生成AIを含むHPC全体 HPC-related incl. Gen. AI	前半期比 +24% HoH	前半期比 +4% HoH	前半期比 +56% HoH
うちロジック (生成AIを含む) (*) of which Logic (incl. Gen AI) (*)	前半期比 -11% HoH	前半期比 +84% HoH	前半期比 +50% HoH
うちHBM of which HBM	前半期比 +65% HoH	前半期比 -48% HoH	前半期比 +68% HoH
SPE受注高に占めるHPC関連の割合 HPC-related proportion of total SPE orders	40%	40%	40%強 / Low 40%

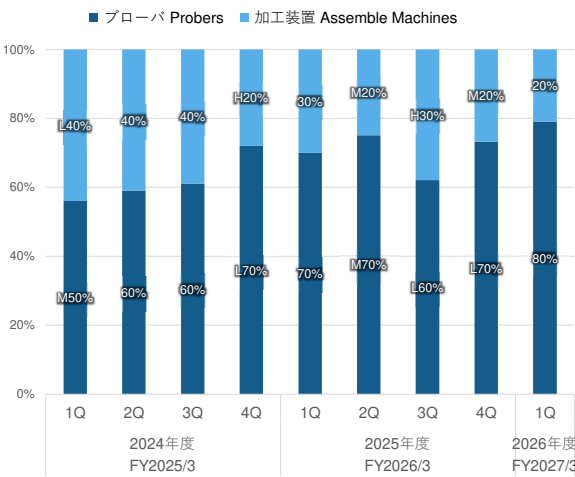
- 変動が大きいため、四半期別の開示は行っておりません。 Due to significant volatilities, the Company does not provide quarterly forecasts.
- 『生成AIを含むHPC全体』は、「うちロジック(生成AIを含む)」および「うちHBM」の合計です。「うちロジック(生成AIを含む)」には、ロジックデバイス向けブローパやAIパッケージング向けの加工装置の需要が含まれています。なお、当社は製品の特性上、検査や加工がおこなわれる半導体デバイスの種別を特定することが困難であることから、生成AIに限定した分類は行っておりません。"HPC-related incl. Gen.AI" represents the sum of 'of which Logic (incl. Gen.AI)' and 'of which HBM'. The 'of which Logic (incl. Gen. AI)' encompasses businesses for probers for logic devices and assembly equipment for AI packaging. Note that due to the nature of our products, it is difficult to identify the specific types of semiconductor devices undergoing inspection or processing; consequently, the Company does not undertake classification limited solely to Generative AI.

Supplementary Data - 製品別構成比 半導体 / SPE Segment per Product

<売上高 Sales>

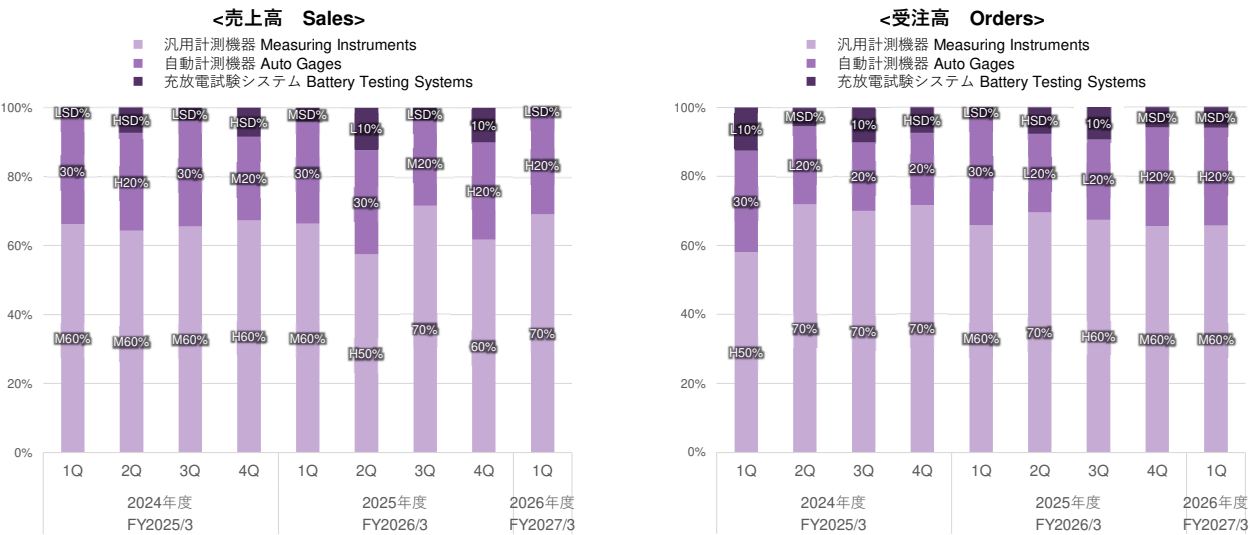


<受注高 Orders>



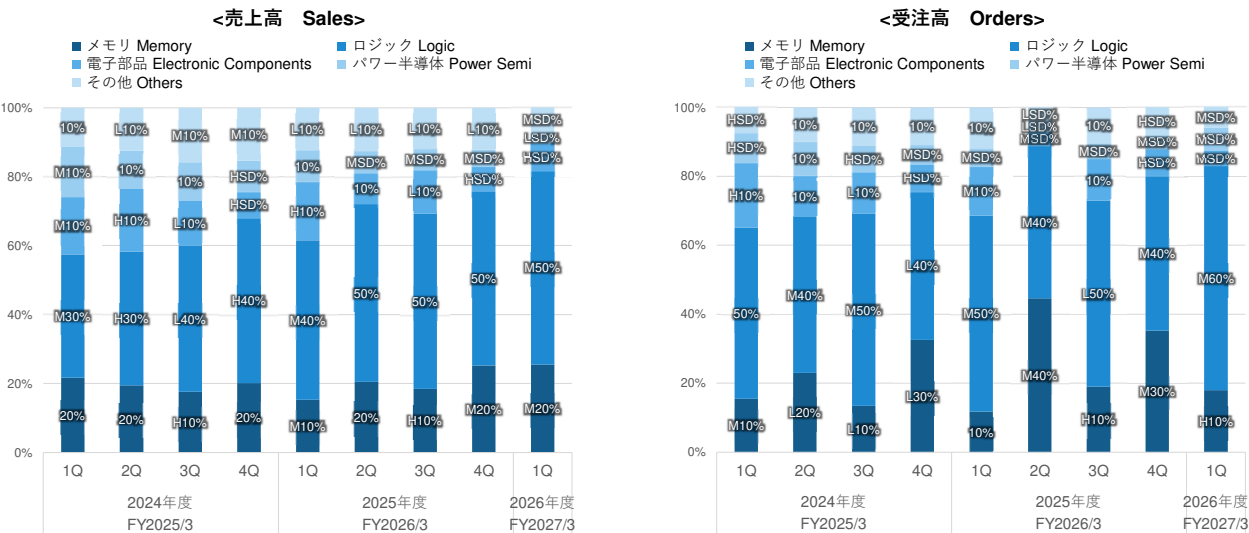
備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%)、MSD%：一桁%半ば (4-6%)、HSD%:一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4-6%), and HSD%: High Single Digit % (7-9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - 製品別構成比 計測 / Metrology Segment per Product



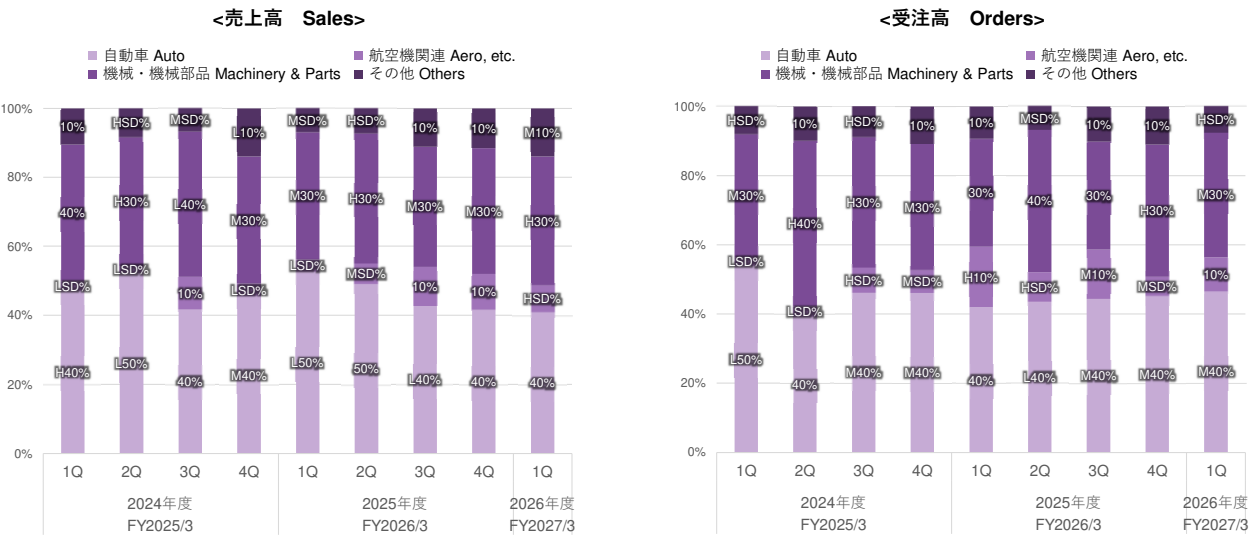
備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%)、MSD%：一桁%半ば (4-6%)、HSD%:一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4-6%), and HSD%: High Single Digit % (7-9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - アプリ別構成比 半導体 / SPE Segment per Application



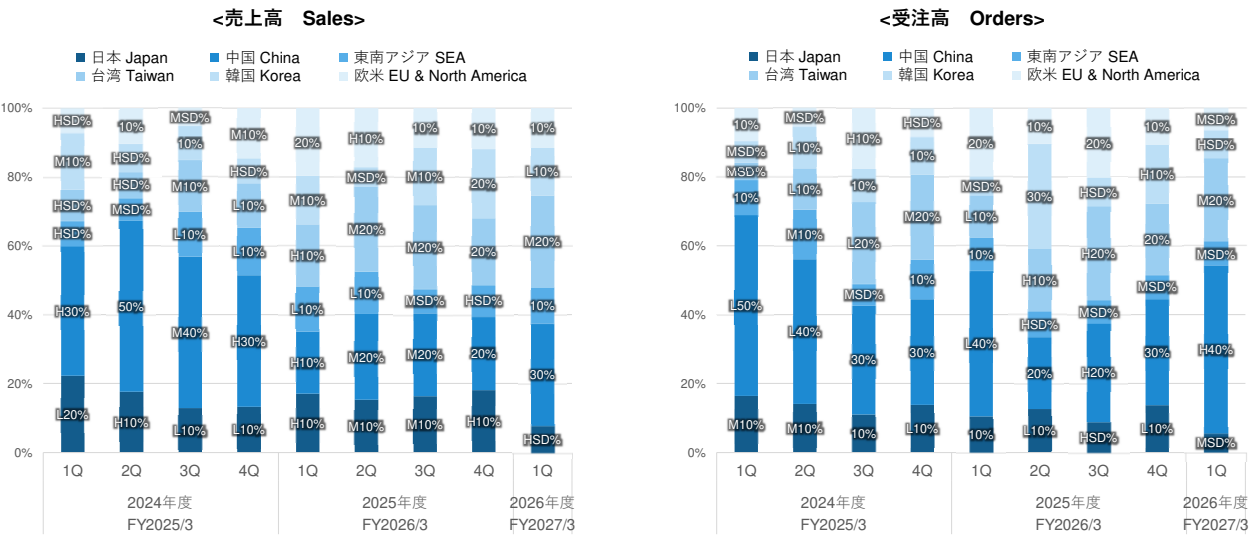
備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%)、MSD%：一桁%半ば (4-6%)、HSD%：一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4-6%), and HSD%: High Single Digit % (7-9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - アプリ別構成比 計測 / Metrology Segment per Application



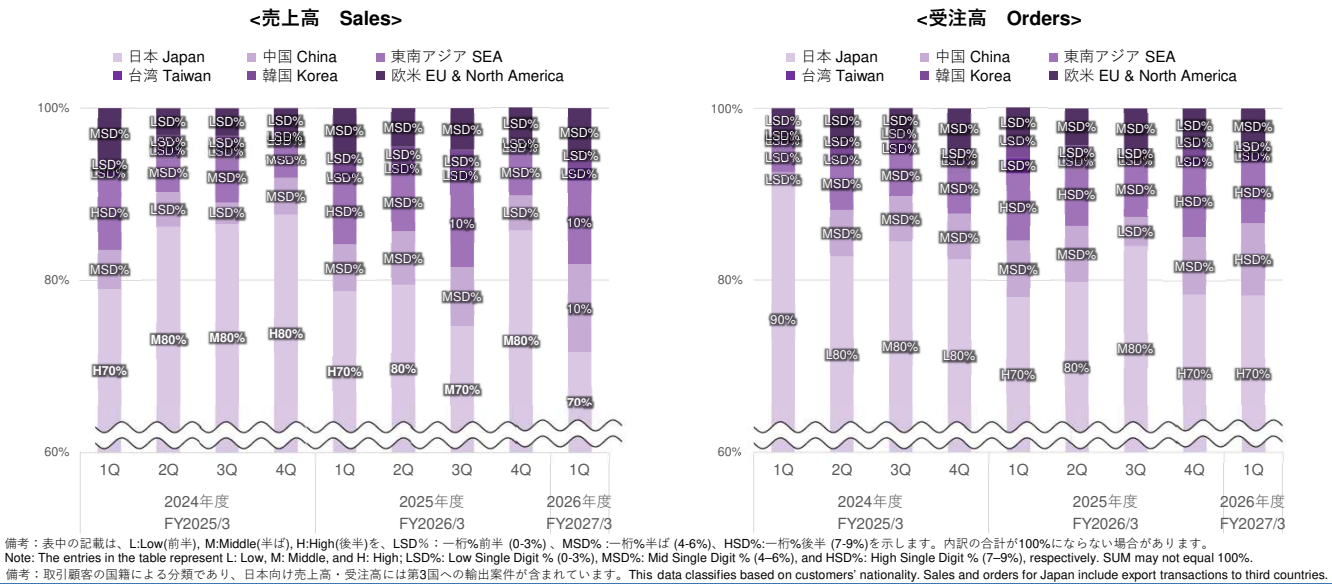
備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%)、MSD%：一桁%半ば (4-6%)、HSD%：一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4-6%), and HSD%: High Single Digit % (7-9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - 地域別構成比 半導体 / SPE per Region



備考：表中の記載は、L:Low(前半), M:Middle(半ば), H:High(後半)を、LSD%：一桁%前半 (0-3%)、MSD%：一桁%半ば (4-6%)、HSD%：一桁%後半 (7-9%)を示します。内訳の合計が100%にならない場合があります。
Note: The entries in the table represent L: Low, M: Middle, and H: High; LSD%: Low Single Digit % (0-3%), MSD%: Mid Single Digit % (4-6%), and HSD%: High Single Digit % (7-9%), respectively. SUM may not equal 100%.

Supplementary Data - 地域別構成比 計測 / Metrology per Region



Supplementary Data - セグメント別業績推移 / Segment Information

(百万円) Million Yen	連結会計期間 Consolidated Fiscal Year				四半期 Quarterly							
	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2026年 3月期 FY2026/3	2026年3月期 FY2026/3				2027年3月期 FY2027/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Orders 受注額	半導体 SPE	99,366	86,082	107,713	123,396	26,378	34,945	25,965	36,106	53,236		
	計測 Metr.	36,960	34,802	37,917	39,700	9,523	9,786	10,661	9,728	12,583		
	合計 Total	136,326	120,885	145,631	163,096	35,901	44,732	36,627	45,835	65,820		
Backlog 受注残高	半導体 SPE	89,371	75,398	69,630	65,149	72,466	71,541	70,134	65,149	89,870		
	計測 Metr.	12,428	12,606	13,470	14,210	15,660	15,123	17,257	14,210	18,592		
	合計 Total	101,799	88,004	83,101	79,359	88,127	86,664	87,391	79,359	108,463		
Sales 売上額	半導体 SPE	112,365	100,055	113,481	127,878	23,542	35,870	27,372	41,092	28,515		
	計測 Metr.	34,436	34,624	37,053	38,960	7,333	10,323	8,528	12,775	8,201		
	合計 Total	146,801	134,680	150,534	166,839	30,876	46,194	35,900	53,867	36,716		
Op 営業利益	半導体 SPE	29,866	19,899	24,311	28,404	4,031	8,297	5,347	10,727	5,409		
	計測 Metr.	4,628	5,408	5,392	5,333	549	1,838	867	2,077	511		
	合計 Total	34,494	25,307	29,703	33,738	4,581	10,136	6,214	12,805	5,920		
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	26.6%	19.9%	21.4%	22.2%	17.1%	23.1%	19.5%	26.1%	19.0%		
	計測 Metr.	13.4%	15.6%	14.6%	13.7%	7.5%	17.8%	10.2%	16.3%	6.2%		
	合計 Total	23.5%	18.8%	19.7%	20.2%	14.8%	21.9%	17.3%	23.8%	16.1%		

Supplementary Data - 損益計算書 / Income Statement

(百万円 (EPS除く)) Million Yen(excl. EPS)	連結会計期間 Consolidated Fiscal Year				四半期 Quarterly							
	2023年 3月期 FY2023/3	2024年 3月期 FY2024/3	2025年 3月期 FY2025/3	2026年 3月期 FY2026/3	2026年3月期 FY2026/3				2027年3月期 FY2027/3			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高 Net Sales	146,801	134,680	150,534	166,839	30,876	46,194	35,900	53,867	36,716			
売上原価 Cost of goods sold	84,967	79,917	88,081	97,978	18,468	27,411	21,063	31,034	21,316			
売上総利益 Gross Profit on Sales	61,834	54,762	62,453	68,860	12,407	18,783	14,837	22,832	15,400			
販売費および一般管理費 Selling, general and administrative expenses	27,339	29,454	32,750	35,122	7,825	8,647	8,622	10,026	9,479			
営業利益 Operating profit	34,494	25,307	29,703	33,738	4,581	10,136	6,214	12,805	5,920			
営業外収益 Non-operating income	965	1,404	921	1,481	133	309	609	428	576			
営業外費用 Non-operating expenses	162	259	684	394	252	-69	84	126	66			
経常利益 Recurring Profit	35,297	26,453	29,939	34,825	4,462	10,515	6,739	13,108	6,430			
特別利益 Extraordinary gains	103	824	4,493	194	3	85	105	0	3			
特別損失 Extraordinary losses	2,099	21	158	1,833	-	2,103	-	-269	-			
税金等調整前当期/四半期純利益 Profit before income taxes and minority interests	33,301	27,255	34,275	33,186	4,465	8,498	6,844	13,377	6,434			
法人税等合計 Total income tax and others	9,607	7,791	8,531	8,354	1,228	2,090	2,268	2,768	1,698			
非支配株主に帰属する当期/四半期純利益 Net Profit attributable to minority interests	62	84	106	92	7	25	39	18	67			
親会社株主に帰属する当期/四半期純利益 Net Profit attributable to Owners of the Parent	23,630	19,378	25,637	24,739	3,229	6,382	4,536	10,590	4,667			
1株当たり当期/四半期純利益(円) Net Profit per Share(Yen)	581.33	480.49	633.75	610.02	79.77	157.32	112.74	260.73	115.01			
潜在株式調整後 1株当たり当期/四半期純利益(円) Net Profit per Share(diluted)(Yen)	575.62	475.42	628.31	606.14	-	-	-	-	-			

Supplementary Data - 貸借対照表 / Balance Sheet

(百万円)(Million Yen)		2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	2027年3月期 第1四半期 FY2027/3 1Q
流動資産 Current Assets	現金及び預金 Cash and cash equivalents	36,782	54,541	53,073	59,925
	売上債権※1 Accounts Receivable※1	42,801	39,809	47,877	39,355
	棚卸資産 Inventories	67,225	69,513	68,022	73,017
	その他 Others	7,022	5,477	5,634	2,259
	合計 Total	153,831	169,341	174,607	174,558
固定資産合計 Total Fixed Assets		71,693	68,610	75,925	76,973
総資産 Total Assets		225,524	237,952	250,533	251,531
流動負債 Current Liabilities	買入債務※2 Accounts Payable※2	17,845	16,665	17,529	18,651
	その他 Others	28,156	30,268	30,350	32,490
	合計 Total	46,002	46,933	47,879	51,141
固定負債合計 Total long-term liabilities		21,094	14,789	9,737	8,330
負債合計 Total Liabilities		67,097	61,723	57,617	59,472
純資産合計 Total Net Assets		158,427	176,229	192,916	192,058
負債・純資産合計 Total Liabilities and Net Assets		225,524	237,952	250,533	251,531
有利子負債合計 Total interest-bearing debt		25,171	20,084	14,713	13,181
自己資本比率 Equity Ratio(%)		69.4%	73.2%	76.3%	75.6%
自己資本利益率 ROE(%)		12.9%	15.5%	13.5%	-

※1: 電子記録債権、契約資産を含みます。 Incl. Electronically recorded monetary claims.

※2: 電子記録債務を含みます。 Incl. Electronically recorded obligations-operating.

Supplementary Data - 各種費用, キャッシュフロー/ Expenses and Cash

(百万円)(Million Yen)	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	2027年3月期 第1四半期 FY2027/3 1Q
研究開発費 R&D expenses	9,042	10,354	12,037	3,333
設備投資 Capex	11,602	10,245	11,069	1,930
減価償却費（のれんの償却を除く） Depreciation (excl. Amortization of goodwill)	4,673	5,105	5,582	1,437

(百万円)(Million Yen)	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3
営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	4,892	28,824	25,012
投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	-10,563	2,541	-11,491
フリーキャッシュフロー Free cash flows	-5,671	31,365	13,520
財務活動によるキャッシュフロー Cash flows from financing activities	1,616	-13,991	-15,674
現金及び現金同等物に係る換算差額等 Adjustments	755	404	689
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at the end of year	36,736	54,516	53,052

(従業員) (# of Employees)	2024年3月期 FY2024/3	2025年3月期 FY2025/3	2026年3月期 FY2026/3	2027年3月期 第1四半期 FY2027/3 1Q
正社員合計 Total full-time employees	2,658	2,767	2,890	2,994
期間平均臨時従業員数 (外資) Average number of part-time employees, not included in the above figure	1,225	1,258	1,365	1,370
従業員合計 (※1) Number of employees	3,883	4,025	4,255	4,364

※1: 従業員合計は、正社員合計人数と、期間平均臨時従業員数の単純合算です。"Number of employees" is a simple sum of the total number of regular employees and the average number of temporary employees during the period.